

## 论坛六十七. 集成电路材料产业发展论坛

分会主席：张锁江、孙蓉、俞文杰

单元 67-1：10月10日上午

主持人：XXX, XXX

地点：浙江·温州瓯海区奥体中心 B3-05

09:45-10:15 A01-01

电子信息化学品及材料的工程科学问题

张锁江

中国科学院

中国科学院过程工程研究所

中国化工学会电子化学品专委会

河南大学

王海梅

万华化学集团股份有限公司

15:00-15:20 A01-08

电子电路基材及原材料发展趋势

任英杰

浙江华正新材料公司通信材料研究院

10:15-10:45 A01-02

题目

任其龙

中国工程院

浙江大学衢州研究院

15:20-15:50 茶歇

10:45-11:00 茶歇

15:50-16:10 A01-09

中国电子大宗气体市场及发展

董晓阳

广州广钢气体能源股份有限公司

11:00-11:30 A01-03

题目

彭孝军

中国科学院

大连理工大学深圳研究院

16:10-16:30 A01-10

集成电路先进封装临时键合材料

张国平

深圳市化讯半导体材料有限公司

11:30-12:00 A01-04

聚合物基先进电子封装材料研究与应用

孙蓉

中国科学院深圳先进技术研究院材料所

深圳先进电子材料国际创新研究院

16:30-16:50 A01-11

电子大宗气站的国产化替代

陈闻翊

宏芯气体(上海)有限公司

s

12:00-14:00 午餐

16:50-17:10 A01-12

超高选择湿式蚀刻在半导体产业的应用与挑战

刘义城

联仕(昆山)化学材料有限公司

14:00-14:20 A01-05

题目

胡金波

中国科学院上海分院

17:10-17:30 A01-13

深耕电子化学品产业链，助力半导体稳健发展

贺兆波

湖北兴福电子材料股份有限公司

14:20-14:40 A01-06

题目

冯黎

上海集成电路材料研究院

17:30-17:50 A01-14

低介电微孔聚合物材料的绿色可控制备

赵玲

华东理工大学发展规划处

上海电子化学品创新研究院

14:40-15:00 A01-07

万华化学面向先进封装领域的材料综合解决方案